(19) **日本国特許庁(JP)**

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2016-115714 (P2016-115714A)

(43) 公開日 平成28年6月23日(2016.6.23)

(51) Int.Cl.			F I			テーマコード(参考)
HO1L	51/50	(2006.01)	HO5B	33/22	D	3 K 1 O 7
H05B	33/26	(2006.01)	HO5B	33/26	Z	
			HO5B	33/14	A	
			H05B	33/22	C	

審査譜求 未譜求 譜求項の数 7 〇 L (全 21 頁)

		審査請求	未請求	請求項(の数 7	OL	(全	21 頁)
(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2014-251029 (P2014-251029) 平成26年12月11日 (2014.12.11)	(71) 出願人		.73 生JOL 千代田区		町三丁	目23	番地
		(74) 代理人	1100019 特許業 所	900 第法人	ナカジ	マ知的	財産綜	合事務
		(72) 発明者	大阪府	^{俗樹} 門真市大 ク株式会		100	6番地	パナ
		Fターム (参	考) 3K10	DD44X DD84 DD84 GG06	BB01 DD72 DD87	CC05 DD73 FF08	CC25 DD78 FF15	DD23 DD79 GG05

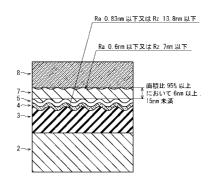
(54) 【発明の名称】有機ELパネル

(57)【要約】 (修正有)

【課題】有機 E L パネルの光出射効率を向上する。

【解決手段】有機 E L パネルにおいて、基板と、アルミニウムを含む陽極層 3 と、樹脂を含み湿式成膜法により形成されたホール輸送層 7 と、有機発光層 8 と、陰極層とを、当該順に積層された状態で備え、陽極層 3 は、ホール輸送層 7 側の表面の表面粗さが、算術平均粗さ R aが 0 . 8 3 n m以下、又は最大高さ R z が 1 3 . 8 n m以下の少なくとも何れかであり、ホール輸送層 7 は、陽極層 3 と重なる範囲のうち面積比 9 5 %以上において厚みが 6 n m以上 1 5 n m未満である。

【選択図】図5



【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板と、

アルミニウムを含む陽極層と、

樹脂を含み湿式成膜法により形成されたホール輸送層と、

有機発光層と、

陰極層とを、当該順に積層された状態で備え、

前記陽極層は、前記ホール輸送層側の表面の表面粗さが、算術平均粗さRa0.83n m以下、又は最大高さRz13.8nm以下の少なくとも何れかであり、

前 記 ホ ー ル 輸 送 層 は 、 前 記 陽 極 層 と 重 な る 範 囲 の う ち 面 積 比 9 5 % 以 上 に お い て 厚 み が 6 n m 以上 1 5 n m 未満である

有機ELパネル。

【請求項2】

前記ホール輸送層は、前記有機発光層側の表面の表面粗さが、算術平均粗さRa0.6 nm以下、又は最大高さRz7nm以下の少なくとも何れかである

【請求項3】

前記陽極層は、厚みは50nm以上200nm未満である 請求項1に記載の有機ELパネル。

【請求項4】

さらに、前記陽極層と前記ホール輸送層との間に遷移金属酸化物からなるホール注入層

請求項1から3の何れかに記載の有機ELパネル。

【請求項5】

前記陽極層は、ニッケル又はコバルトを含むアルミニウム合金を含み、前記陽極層の前 記ホール注入層側の表面では、少なくとも一部においてニッケル又はコバルトが前記ホー ル注入層と接している

請求項4に記載の有機ELパネル。

請求項1に記載の有機 E L パネル。

【請求項6】

前記ニッケル又はコバルト又はそれらが構成する酸化物は、キャリアとしてのホールを 注入するホール注入性を備える

請求項5に記載の有機ELパネル。

【 請 求 項 7 】

前記陽極層は、基板の上にアルミニウム、及びアルミニウムニッケル合金、又はアルミ ニウムコバルト合金をスパッタリングにより堆積したのち焼成して形成されている 請求項1に記載の有機ELパネル。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[00001]

本開示は、有機材料の電界発光現象を利用した有機EL(Electro Lumin escence)パネルに関する。

【背景技術】

[00002]

近年、デジタルテレビ等の表示装置に用いられる表示パネルとして、基板上に有機発光 素 子 を マ ト リ ッ ク ス 状 に 複 数 配 列 し た 有 機 E L 素 子 を 利 用 し た パ ネ ル (以 後 、 「 有 機 E L パネル」と略称する)が実用化されている。

各有機EL素子は電流駆動型の発光素子であって、陽極と陰極の一対の電極対の間に有 機 発 光 材 料 を 含 む 発 光 層 が 配 設 さ れ た 基 本 構 造 を 有 す る 。 陽 極 と 有 機 発 光 層 と の 間 、 並 び に陰極と有機発光層との間には、必要に応じて電荷注入層、電荷輸送層などが介設されて いる。駆動時には、一対の電極対間に電圧を印加し、陽極から有機発光層に注入されるホ 10

20

30

40

ールと、陰極から有機発光層に注入される電子との再結合に伴って発光する。陽極と有機発光層の間には、ホールを効率よく有機発光層に注入するためのホール注入層が形成される。

[0003]

有機 E L パネルの一般的な製造工程では、T F T 層を形成した基板上に樹脂材料からなる絶縁層を形成し、その上に陽極材料として、たとえばアルミニウムまたはアルミニウム合金を含む金属材料層を成膜し、この金属材料層を焼成して陽極を形成する。そして、その上に、例えば遷移金属酸化物膜からなるホール注入層を形成し、さらに、湿式成膜法により樹脂を含むインクと塗布してホール輸送層、有機発光層、陰極を形成する(例えば、特許文献 1 参照)。

【先行技術文献】

【特許文献】

[0004]

【特許文献1】国際公開番号 WO2012/001727号

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[00005]

ところが、従来の有機 E L パネルでは、パネルが多くの層を積層して形成されているために、何れかの層において形成不良が生じた場合には当該部分において発光特性が低下し、有機 E L パネルの光出射効率が低下する。本開示は、上記課題に鑑み、光出射効率を向上する有機 E L パネルを提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0006]

上記課題を解決するために、本開示の一態様における有機 E L パネルは、基板と、アルミニウムを含む陽極層と、樹脂を含み湿式成膜法により形成されたホール輸送層と、有機発光層と、陰極層とを、当該順に積層された状態で備え、前記陽極層は、前記ホール輸送層側の表面の表面粗さが、算術平均粗さ R a が 0 .8 3 n m 以下、又は最大高さ R z が 1 3 .8 n m 以下の少なくとも何れかであり、前記ホール輸送層は、前記陽極層と重なる範囲のうち面積比 9 5 %以上において厚みが 6 n m 以上 1 5 n m 未満であることを特徴とする。

【発明の効果】

[0007]

本開示の一態様に係る有機 E L パネルでは、上記した構成により、ホール輸送層の層断裂領域又は薄膜化領域の発生を抑制できる。そのため、層断裂領域又は薄膜化領域とその近傍において有機発光層から適切な光量の発光が得られない電気的劣化要因に基づく光出射効率低下を抑制できる。

【図面の簡単な説明】

[0008]

- 【図1】実施の形態に係る有機 E L パネル100の構成を示す模式的な断面図である。
- 【図2】実施の形態の有機EL素子の製造工程の一部を示すフロー図である。
- 【図3】有機ELパネル100の製造工程の一部を示す模式断面図である。
- 【 図 4 】 有機 E L パネル 1 0 0 の 製 造 工 程 の 一 部 を 示 す 模 式 断 面 図 で あ る 。
- 【図5】有機ELパネル100における絶縁層、ホール注入層、ホール輸送層及び陽極層の構成を示す模式的な断面図である。
- 【図6】有機ELパネル100の性能評価試験における各サンプルの仕様及び製造条件を示す図である。
- 【図7】有機ELパネル100及び比較例の断面観察に用いた試片の形状寸法を示す模式図である。
- 【図8】(a)は、有機ELパネル100における絶縁層、陽極層、ホール注入層、ホール輸送層、TEM用保護層の断面を示す写真であり(b)はA部を拡大した写真である。

10

20

30

40

【図9】(a)は、比較例における絶縁層、陽極層、ホール注入層、ホール輸送層、TEM用保護層の断面を示す写真であり、(b)はC部を拡大した写真、(c)はD部を拡大した写真である。

【図10】(a)~(c)は、有機ELパネル100における陽極層、ホール注入層、ホール輸送層、有機発光層の2値化した断面画像である。

【図11】(a)~(c)は、比較例における陽極層、ホール注入層、ホール輸送層、有機発光層の2値化した断面画像である。

【図12】有機 E L パネル100及び比較例におけるホール輸送層の厚み分布の測定結果を示す図である。

【図13】有機ELパネル100及び比較例における陽極層のホール注入層側表面の表面粗さの測定結果を示す図であり、(a)は算術平均粗さRa、(b)は最大高さRzを示す。

【図14】有機 E L パネル100及び比較例におけるホール注入層のホール注入層側表面粗さと光出射効率との関係を示す図であり、(a)は算術平均粗との関係、(b)は最大高さ R z との関係を示す。

【図15】有機ELパネル100及び比較例における光の波長と反射率との関係を示す実験結果を示す図である。

【図16】従来の有機ELパネル100Xを構成する有機EL素子10Xの構成を示す模式断面図である。

【図17】従来の有機ELパネル100Xにおける陽極層の厚みと光出射効率との関係を示す実験結果及び光学シミュレーション結果を示す図である。

【発明を実施するための形態】

[0009]

発明を実施するための形態に至った経緯について

図16は、特許文献1に記載された従来の有機ELパネル100Xを構成する1つの有機EL素子10Xの構成を示す模式断面図である。図16に示すように、有機EL素子10Xでは、基板101のZ軸方向上側の表面に、TFT層1010およびパッシベーション膜102が順に積層形成され、さらにその上に絶縁層103が積層形成されている。基板101は、例えば、無アルカリガラス、ソーダガラス、無蛍光ガラス、燐酸系ガラス、硼酸系ガラス、石英、又はアルミニウムナ等の絶縁性材料をベースとして形成されている。絶縁層103は、例えば、アクリル、ポリイミド、ゾルゲルなどの有機絶縁材料や、SiNやSiOxなどの無機絶縁材料などから形成されている。TFT層1010は、ゲート電極1011、ドレイン電極1012、ソース電極1013と、チャネル層1014およびゲート絶縁膜1015とから構成されており、陽極層105に対してコンタクトホール(不図示)で接続されている。

[0010]

有機EL素子10Xにおいては、X-Y平面において、画素部10aと非画素部10bとが含まれている。画素部10aにおいては、絶縁層103上に陽極層105が形成されている。非画素部10bにおいては、絶縁層103上に補助電極106が形成されている。陽極層105および補助電極106は、ニッケル(Ni)を含み、アルミニウムを主成分とする合金材料から構成されている。

[0011]

隣接する陽極層105同士の間、および隣接する陽極層105と補助電極106との間には、各々バンク107が立設されている。画素部10aにおいては、陽極層105上に、ホール注入層105 X、ホール輸送層108、有機発光層109、電子輸送層110、および陰極層111が順に積層形成されている。このうち、電子輸送層110と陰極層111とは、非画素部10bにも連続して形成され、陰極層111と補助電極106とは、間に電子輸送層110が介在した状態で電気的に接続されている。陰極層111の上面は、封止層112により覆われている。

[0012]

50

10

20

30

次に、有機ELパネル100Xの製造工程では、TFT層101およびパッシベーション膜102が順に積層形成され基板上に絶縁層103、陽極層105及び補助電極106を構成する金属材料層を順次形成し、その上に、その後に焼成工程を実施する。成膜した金属材料層を焼成して、陽極層105及び補助電極106の膜密度を向上(焼き締め)して低抵抗化するためである。

[0013]

その後、陽極層105は、それぞれフォトリソグラフィー法に基づき、エッチングしてパターニングして形成する。その後、隣接する陽極層105同士の間、および隣接する陽極層105と補助電極106との間に、フォトリソグラフィー法に基づき、各々バンク107を形成した後、陽極層105上及びホール注入層105X上に塗布法によりホール輸送層108を形成する。その後、ホール輸送層108の上に、塗布法により有機発光層109、電子輸送層110、および陰極層111を積層形成して有機ELパネル100Xを完成する。

[0014]

発明者らは、上記した従来の有機ELパネル100Xを用いて光出射効率低下の要因を検討するために実験を行った。図17は、従来の有機ELパネル100Xにおける陽極層105の厚みと光出射効率との関係を示す実験結果及び光学シミュレーション結果を示す図である。実験では、有機ELパネル100Xに10(mA/cm²)の電流を流し青色光(波長380mmから495mm)を発光させたときの光度(Cd)を測定して、こでは、これで除して光出射効率を算出した。図17に示すように、光学シミュレーションは陽極層厚みが200mmの範囲において、光出射効率は約±2%(5.3~5.5(Cd/A))の範囲内で変動する。これに対し、有機ELパネル100Xに対っち、5.5(Cd/A))の範囲内で変動する。これに対し、大きとき、光学シミュレーションは約15%(5.3~4.5(Cd/A))単調減少すると。また、光学シミュレーションは約15%(5.3~4.5(Cd/A))単調減少すると、光学シミュレーション結果が一致するが、陽極層厚みが200mmよりも大きく400mm以下では、実験結果が光学シミュレーション結果を下回り、陽極層厚の増加に伴いその差は拡大する。

[0015]

一般に、トップエミッション型の有機 E L パネル 1 0 0 X では、 陽極層 1 0 5 厚みが増加したとき陽極層 1 0 5 の表面粗さの増加に伴う陽極層反射率の低下が生じることが知られている(例えば、特開 2 0 1 2 - 1 0 4 5 5 3 号公報参照)。その場合、青色光においては陽極層 1 0 5 厚みが約 2 倍に増加したとき陽極層 1 0 5 の反射率が約 1 %低下し、これに伴い発光した光の取だし効率が低下するために有機 E L パネルの光出射効率も低下する。これに対し、上述のとおり有機 E L パネル 1 0 0 X では、 陽極層 1 0 5 厚みが約 2 倍に増加したとき約 1 5 % 光出射効率低下が生じた。

[0016]

そこで、発明者らは、陽極層105の表面粗さの増加に伴う陽極層反射率の低下という 光学的要因以外に、陽極層105厚みの増加に伴う光出射効率低下の要因が存在すると考 え、陽極層105厚み増加に伴う光出射効率低下の要因について検討を行った。

その結果、陽極層105上及びホール注入層105X上に塗布法によりホール輸送層108を形成する工程において、主に陽極層105厚み増加に伴う表面粗さ増加に起因して、陽極層105又はホール注入層105Xと有機発光層109とが部分的に接合しホール輸送層108が層内部で断裂した層断裂領域、又はホール輸送層108が所定厚み未満の範囲に薄化した薄膜化領域が面内でスポット状に発生していることを見出した。この層断裂領域又は薄膜化領域(以後、「層断裂又は薄膜化領域」とする)とその近傍では、陽極層105から有機発光層109に十分なキャリア移動がなされないために有機発光層109において適切な光量の発光が得られず、層断裂又は薄膜化領域の増加が光出射効率低下の主要因であると考えられる。

[0017]

50

10

20

30

そこで、ホール輸送層 1 0 8 を形成する工程において層断裂又は薄膜化領域の発生を抑制することが可能な有機 E L 素子のデバイス構造ついて検討を行い、実施の形態に係る有機 E L 素子に想到したものである。

発明を実施するための形態の概要

本実施の形態に係る有機 E L パネルは、基板と、アルミニウムを含む陽極層と、樹脂を含み湿式成膜法により形成されたホール輸送層と、有機発光層と、陰極層とを、当該順に積層された状態で備え、前記陽極層は、前記ホール輸送層側の表面の表面粗さが、算術平均粗さ R a 0 . 8 3 n m以下、又は最大高さ R z 1 3 . 8 n m以下の少なくとも何れかであり、前記ホール輸送層は、前記陽極層と重なる範囲のうち面積比 9 5 %以上において厚みが 6 n m以上 1 5 n m未満であることを特徴とする。

[0018]

また、別の態様では、前記ホール輸送層は、前記有機発光層側の表面の表面粗さが、算術平均粗さRaO.6nm以下、又は最大高さRz7nm以下の少なくとも何れかである構成であってもよい。

また、別の態様では、前記陽極層は、厚みは50nm以上200nm未満である構成であってもよい。

[0019]

また、別の態様では、さらに、前記陽極層と前記ホール輸送層との間に遷移金属酸化物からなるホール注入層を備えた構成であってもよい。

また、別の態様では、前記陽極層は、ニッケル又はコバルトを含むアルミニウム合金を含み、前記陽極層の前記ホール注入層側の表面では、少なくとも一部においてニッケル又はコバルトが前記ホール注入層と接している構成であってもよい。

[0020]

また、別の態様では、前記ニッケル又はコバルト又はそれらが構成する酸化物は、キャリアとしてのホールを注入するホール注入性を備える構成であってもよい。

また、別の態様では、前記陽極層は、基板の上にアルミニウム、及びアルミニウムニッケル合金、又はアルミニウムコバルト合金をスパッタリングにより堆積したのち焼成して 形成されている構成であってもよい。

[0021]

実施の形態

1.構成について

実施の形態に係る有機 E L パネル 1 0 0 の構成について、図 1 を用い説明する。図 1 は、本開示の有機 E L パネルの一態様として、実施の形態に係る有機 E L パネル 1 0 0 の構成を模式的に示す断面図である。有機 E L パネル 1 0 0 は、これに接続された駆動制御部(不図示)とで表示装置を構成することができる。

[0022]

有機 E L パネル 1 0 0 では、画素(ピクセル)が基板 1 の上面に沿ってマトリクス状に配列されている。各画素は隣接する R G B 3 色のサブ画素の有機 E L 素子を 1 組として構成される。有機 E L 素子 2 0 a、 2 0 b、 2 0 c は、基板 1 上に配列されたトップエミッション型であって、有機 E L 素子 2 0 a は青色のサブ画素、有機 E L 素子 2 0 b は緑色のサブ画素、有機 E L 素子 2 0 c は赤色のサブ画素にそれぞれ相当する。

[0 0 2 3]

基板1は、基板本体(不図示)の上面に、有機 E L パネル100全体の有機 E L 素子20a~20cをアクティブマトリクス方式で駆動するためのTFT層(不図示)が形成されてなり、その上を絶縁層2で被覆されて構成されている。

基板本体は、有機 E L パネル 1 0 0 のベース部分となる基板であって、無アルカリガラス、ソーダガラス、無蛍光ガラス、燐酸系ガラス、硼酸系ガラス、石英、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂、又はアルミニウムナ等の無機絶縁性材料で形成されている。

[0 0 2 4]

絶縁層2は、基板1の表面を平坦にし、且つTFTを外部より絶縁するために設ける樹

10

20

30

40

20

30

40

50

脂膜であって、絶縁性に優れる有機材料、例えばポリイミド、ポリアミド、アクリル系樹脂材料等の有機絶縁性材料で形成されている。また、絶縁層 2 は、膜厚によっては、基板 1 の表面を平坦化する機能を有する平坦化層であってもよい。

次に、有機EL素子20a~20cの素子の構成について説明する。絶縁層2上には、陽極層3、透明電極4、ホール注入層5、有機発光層8、電子注入層9、陰極層10、封止層11が順次積層形成されている。

[0025]

陽極層3は、ここではアルミニウム又はアルミニウム合金を含む電気抵抗の低い材料で構成され、厚み(膜厚)は好ましくは50nm以上200nm未満、より好ましくは75nm以上150nm以下の反射陽極層として形成されている。アルミニウムやアルミニウム合金は、高光反射性を有する高導電性金属材料であり好適である。アルミニウム合金の例としては、アルミニウムコバルト合金(例えば、A1gCo₂)、又は、アルミニウムニッケル合金(例えば、A1g・ロ・フルミニウムコバルト・ゲルマスは、アルミニウムニッケル合金に加えて、例えば、アルミニウム・コバルト・ゲルマニウム・ランタン(A1・Co・Ge・La)合金、アルミニウム・カーボン・マグネシウム(A1・C・Mg)合金や、アルミニウムネオジウム(A1・Nd)合金、アルミニウムジルコニウム(A1・Zr)合金、アルミニウム銅(A1・Cu)合金、アルミニウムシリコン(A1・Si)合金、アルミニウムシリコン(A1・Si)合金、アルミニウムシリコン(A1・Si)合金、アルミニウムシリコン・銅(A1・Si・Cu)合金などを用いてもよい。

[0026]

透明電極4は、インジウムを含む導電性材料、例えばIZO(酸化インジウム亜鉛)等の透明電極材料で構成される。厚みが約16nm程度の膜であり、陽極層3の上面を被覆している。なお陽極層3と透明電極4とを併せて陽極層とすることもある。

陽極層3及び透明電極4は、各サブ画素を構成する有機EL素子20a、20b、20 c ごとに分離してパターニングされている。

[0027]

ホール注入層 5 は、有機発光層 8 に対して陽極層 3 側からホールを効率よく注入するための層であり、例えば、酸化モリブデン(MoOx)や酸化タングステン(WOx)の遷移金属酸化物膜で形成されている(xは正数)。その他、例えば、銀(Ag)、クロム(Cr)、バナジウム(V)、ニッケル(Ni)、イリジウム(Ir)などの酸化物、あるいは、PEDOT(ポリチオフェンとポリスチレンスルホン酸との混合物)などの導電性ポリマー材料からなる層を用いてもよい。ホール注入層 5 の厚みは、0.1~20nm程度の範囲内が好ましい。なお、ホール注入層 5 は、有機EL素子20a、20b、20cごとに分離してパターニングされている。

[0028]

ホール注入層5を遷移金属の酸化物から構成する場合には、複数の酸化数をとるためこれにより複数の準位をとることができ、その結果、ホール注入が容易になり駆動電圧を低減することができる。特に、酸化タングステン(WOx)を用いることが、ホールを安定的に注入し、且つ、ホールの生成を補助するという機能を有するという観点から望ましい。本実施の形態では、酸化タングステン(WOx)(WOx:約10[nm])を採用している。ただし、層厚はこれに限定されるものではなく、例えば、酸化タングステン(WOx)の層厚は、5[nm]~30[nm]の範囲とすることができる。

[0029]

ホール注入層 5 の上には、少なくとも隣り合うサブピクセル同士の間を仕切るように、 絶縁材料からなるバンク 6 が設けられている。バンク 6 は、個々の有機 E L 素子 2 0 a 、 2 0 b 、 2 0 c の有機発光層 8 を個別に区画するいわゆるピクセルバンク構造としてもよいし、同発光色の有機 E L 素子 2 0 a 、 2 0 b 、 2 0 c の有機発光層 8 を一群ずつストライプ状に区画する、ラインバンク構造としてもよい。

[0030]

バンク6は、絶縁性を有する樹脂等の有機材料で形成され、形成工程においてエッチン

グ処理、ベーク処理などが施される。有機材料の例としてはアクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂、ノボラック型フェノール樹脂等が挙げられる。

バンク 6 で仕切られた領域内には、ホール輸送層 7 、有機発光層 8 が積層形成されている。

[0031]

ホール輸送層 7 は、陽極層 3 側からホールを輸送し、有機発光層 8 に注入する役目を持つ。その材料の具体例としては、 4 、 4 ' - ビス [N - (ナフチル) - N - フェニル - アミノ] ビフェニル(- N P B または - N P D) 、 N 、 N ' - ビス (3 - メチルフェニル) - (1 、 1 ' - ビフェニル) - 4 、 4 ' - ジアミン (T P D) などのトリアリールアミン系化合物を挙げることができる。これらの材料を含む溶液を用いた湿式成膜法(ウェットプロセス)で作製できる。

[0032]

有機発光層8は、ホールと電子とが注入されて再結合されることにより励起状態が生成 され、これにより発光する機能を有する。有機発光層8もウェット法で形成できる。その 材料は、例えば特許公開公報(特開平5-163488号公報)に記載のオキシノイド化 合物、ペリレン化合物、クマリン化合物、アザクマリン化合物、オキサゾール化合物、オ キサジアゾール化合物、ペリノン化合物、ピロロピロール化合物、ナフタレン化合物、ア ントラセン化合物、フルオレン化合物、フルオランテン化合物、テトラセン化合物、ピレ ン化合物、コロネン化合物、キノロン化合物及びアザキノロン化合物、ピラゾリン誘導体 及びピラゾロン誘導体、ローダミン化合物、クリセン化合物、フェナントレン化合物、シ クロペンタジエン化合物、スチルベン化合物、ジフェニルキノン化合物、スチリル化合物 、 ブ タ ジ エ ン 化 合 物 、 ジ シ ア ノ メ チ レ ン ピ ラ ン 化 合 物 、 ジ シ ア ノ メ チ レ ン チ オ ピ ラ ン 化 合 物、フルオレセイン化合物、ピリリウム化合物、チアピリリウム化合物、セレナピリリウ ム化合物、テルロピリリウム化合物、芳香族アルダジエン化合物、オリゴフェニレン化合 物、チオキサンテン化合物、アンスラセン化合物、シアニン化合物、アクリジン化合物、 8 - ヒドロキシキノリン化合物の金属錯体、 2 - ビピリジン化合物の金属錯体、シッフ塩 とIII族金属との錯体、オキシン金属錯体、希土類錯体などの蛍光物質で形成されるこ とが好ましい。

[0033]

有機発光層 8 の上には、電子注入層 9 、陰極層 1 0 および封止層 1 1 が、バンク 6 の上部を超えてパネル全体の有機 E L 素子 2 0 a、 2 0 b、 2 0 c にわたり連続して形成されている。

電子注入層9は、陰極層10側から注入される電子を有機発光層8へ輸送する機能を有する。例えば、バリウム、フタロシアニン、フッ化リチウム、あるいはこれらを組み合わせた材料で構成される。

[0034]

陰極層10は、例えばITO、IZO(酸化インジウム亜鉛)などの光透過性の材料で形成される。この他に、例えばアルカリ金属、アルカリ土類金属、またはそれらのハロゲン化物を含む層と銀を含む層とをこの順で積層した構造とすることもできる。

封止層11は、有機発光層8などが水分や空気に曝されるのを抑制する機能を有し、例えば、SiN(窒化シリコン)、SiON(酸窒化シリコン)などの光透過性の材料で形成することが好ましい。

[0035]

2.製造方法

有機 E L パネル 1 0 0 の製造方法について図 2 、図 3 及び図 4 を用いて説明する。図 2 は、実施の形態の有機 E L 素子の製造工程の一部を示すフロー図である。図 3 及び図 4 は、有機 E L パネル 1 0 0 の製造工程の一部を示す模式断面図である。

先ず、基板本体を準備する。反応性スパッタ法に基づき、前記基板本体の表面にTFT層を形成し、基板1とする(S1)。

[0036]

10

20

30

20

30

40

50

次に、TFT層を覆うように、厚み約4μmの絶縁層2を形成する(S2、図3(a))。この絶縁層2は、公知の感光性有機材料(例えばシロキサン共重合型感光性ポリイミド)をスピンコートおよびスリットコートして形成できる。また、絶縁層2は、本形態のように、厚みが4μm程度あれば、基板1の表面を平坦化する平坦化層としても機能する

[0037]

次に、絶縁層2の上(基板1の上)に、アルミニウムまたはアルミニウム合金等の金属材料を用い、スパッタリング法により金属材料層3Xを薄膜成形する(S3、図3(b))。陽極層3は、ホール輸送層7側の表面の表面粗さが、算術平均粗さRaが0.83nm以下(JIS B0601(2001)参照)又は最大高さRzが13.8nm以下(JIS B0601(2001)参照)の少なくとも何れかを満たすように構成されている。スパッタリング法により金属材料層3Xを薄膜成形するよきのスパッタリング条件(スパッタリング電力、スパッタリング雰囲気の圧力等)及び膜厚を、成膜される金属材料層3Xの表面粗さを測定して調整することにより、上記範囲に入るよう陽極層3の表面粗さを制御することができる。

[0038]

次に、金属材料層3Xの表面上に、IZO等の透明電極材料からなる透明導電膜4Xを真空成膜法に基づき成膜する(S4、図3(c))。

次に、遷移金属化合物(モリブデンやタングステン等)の金属材料を真空成膜法又は反応性スパッタ法で成膜することによって金属酸化物膜5Xを形成する(S5、図3(d))。

[0039]

次に、金属材料層3X、透明導電膜4X、金属酸化物膜5Xの各成膜の後、金属材料層3Xの焼成工程を行う(S6、図3(e))。これは、金属材料層3X中のニッケル又はコバルトをホール注入層5側の表面に析出させて、陽極層3のホール注入層5側の表面で、少なくとも一部においてアルミニウムとニッケル又はコバルトの結晶をホール注入層5と接触させるためである。その結果、陽極層3のホール注入層5側の表面全体が絶縁体であるアルミニウムの酸化物で覆われ陽極層3とホール注入層5間の電流が遮断されることを防止し、陽極層3とホール注入層5とがアルミニウムとニッケル又はコバルトの結晶を介して接触する構成を採ることができる。そして、陽極層3とホール注入層5とは電気的に接続される。

[0040]

陽極層(金属材料層3 X)の焼成工程は、金属材料層成膜、透明導電膜成膜、金属酸化物膜成膜を全て行った時点で実施する構成としている。焼成温度は、当該焼成工程以前の各工程よりも高い温度(一例として 2 0 0 以上、好ましくは 2 3 0 以上)とし、 1 5 分以上、好ましくは 4 5 分以上の時間で焼成する。この焼成工程の実施により膜密度を向上させ、且つ電気抵抗を低減した金属材料層 3 X が得られる。また、この焼成工程で透明導電膜 4 X の膜密度も向上し、電気抵抗を低減できる。このように金属材料層 3 X と透明導電膜 4 X をまとめて焼成することで、製造工程を容易化することができる。

[0041]

なお、陽極層(金属材料層 3 X)の焼成工程は、金属材料層成膜後、透明導電膜成膜、金属酸化物膜成膜前に実施する構成としてもよい。

次に、フォトグラフィー法に基づいて金属酸化物膜の上に感光性レジストRを塗布し金属酸化物膜5×のパターニングを実施する(S7)。まず金属酸化物膜5×の上面に感光性レジスト膜Rを配設し、パターンマスクの上から露光を行う(図3(f))。感光性レジスト膜Rにポジ型感光性レジストを用いる場合、パターンマスクは陽極層3を形成すべき部分を遮光し、それ以外の部分を露光するように開口部を形成する。その後、アルカリ水溶液からなる現像液(レジスト現像液)を用いてレジスト現像を行う(図4(a))。

[0042]

次に、ドライエッチングに基づいて金属酸化物膜5Xのパターニングを行いホール注入

層5を形成する(S8、図4(b))。

次に、金属材料層 3 X および透明導電膜 4 X とをウエットエッチングすることにより、透明電極 4 、陽極層 3 を形成する(S9、図 4 (c))同じエッチング液を用いて一括エッチングする。エッチング液としては、例えばフッ硝酸系の混酸を用いることができる。

[0043]

その後、不要になったレジストを剥離する(S 1 0 、図 4 (d))。以上で陽極層、透明電極、ホール注入層のパターニング形成が終了する。なお、上記陽極層 3 、透明電極 4 、ホール注入層 5 はドライエッチング、ウエットエッチングのいずれを用いて形成してもよい。また、これらは個別にエッチングするか、またはいずれかと組み合わせて一括エッチングするようにしてもよい。

[0044]

次に、バンク材料として、感光性のレジスト材料、もしくはフッ素系やアクリル系材料を含有するレジスト材料を用意する。この材料をスピンコート法およびスリットコートで前記ホール注入層 5 上に塗布し、フォトレジスト法に基づいてパターニングする。その後、熱キュアすることによってバンク 6 を形成する(S11)。

次に、例えばインクジェット法等、バンク6間の領域内にインクを充填する湿式成膜法に基づきホール輸送層材料を含むインクを滴下する。このインクを乾燥させることでホール輸送層 7 を形成する。ホール輸送層 7 はホール輸送層材料を含むインクを滴下して乾燥する湿式成膜法により成膜される。そのため、インクの粘性を下地の影響を受けにくい範囲に制御することにより、塗布後のインク表面をインクの表面張力により平滑にすることができる。また、塗布したインクを乾燥するときの温度及び乾燥時間を制御することにより、成膜後のホール輸送層 7 の表面粗さを所定の範囲内に収めることができる。具体的には、ホール輸送層 7 は、有機発光層側の表面の表面粗さが、算術平均粗さRaが0.6nm以下又は最大高さRzが7nm以下の少なくとも何れかを満たすよう形成される。

[0045]

さらに、上述した陽極層3の表面粗さの状態において、インクの塗布量を制御することにより、ホール輸送層7は陽極層3と重なる範囲の面積比95%以上の範囲において厚みが6nm以上15nm未満とすることができる。

さらに、ホール輸送層7の上面に、有機EL材料を含むインクを滴下し、そのインクを 乾燥させて有機発光層8を形成する。なお、各インクの塗布方法としては、インクジェット法以外に湿式成膜法として、ディスペンサー法、ノズルコート法、スピンコート法、スリットコート、凹版印刷、凸版印刷等のいずれでも良い。インクの乾燥は、例えば真空乾燥で実施するのが望ましい。インク乾燥後、窒素雰囲気中においてベークを行う。有機発光層8の平均厚みは、例えば70mmとする。

[0046]

次に、有機発光層8およびバンク6を覆うように、真空蒸着法に基づき、バリウムからなる薄膜を成膜する。次に共蒸着法に基づき、バリウムを混合した化合物Alaの膜を、所定の厚み(例えば20nm)で成膜し、電子注入層9とする。

次に、電子注入層9の上に、例えばプラズマコーティング法に基づき、例えば100nmの厚みでIZOの薄膜を成膜し、陰極層10とする。

[0047]

次に、陰極層10の上にSiN、SiON等の材料を用い、真空蒸着法等に基づき、封止層11を成膜する。

以上で有機ELパネル100が完成する。

3 . 有機 E L パネル 1 0 0 の要部構成

次に、有機ELパネル100の要部の構成について説明する。

[0 0 4 8]

図 5 は、有機 E L パネル 1 0 0 における絶縁層 2 、陽極層 3 、透明電極 4 、ホール注入層 5 、ホール輸送層 7 、及び有機発光層 8 の構成を示す模式的な断面図である。上述のとおり、有機 E L パネル 1 0 0 では、無機材料を主成分とする基板 1 の上面に、樹脂を主成

10

20

30

40

20

30

40

50

分とする絶縁層である絶縁層2を備え、絶縁層2の上面に、アルミニウムを含む陽極層3と、遷移金属酸化物からなるホール注入層5と、透明電極4と、樹脂を含み湿式成膜法により形成されたホール輸送層7と、陽極層3から注入されたキャリアを受け取る有機発光層8と、陰極層10とを当該順に積層された状態で備えている。

[0049]

上記構成において、有機 E L パネル 1 0 0 は、陽極層 3 は、ホール輸送層 7 側の表面の表面粗さが、算術平均粗さ R a が 0 . 8 3 n m以下又は最大高さ R z 1 3 . 8 n m以下の少なくとも何れかを満たす構成を採る。また、ホール輸送層 7 は、陽極層 3 と重なる範囲の面積比 9 5 %以上の範囲において厚みが 6 n m以上 1 5 n m未満である構成を採る。

これにより、ホール注入層 5 上に湿式成膜法によりホール輸送層 7 を形成する工程において、陽極層 3 厚み増加に伴う表面粗さの増加に起因して陽極層 3 と有機発光層 8 とが部分的に接合することを防止し、ホール輸送層 7 における層断裂領域又はホール輸送層 7 の厚みが 0 n mより大きく 6 n m未満の範囲に薄化した薄膜化領域の発生頻度を削減することができる。そのため、ホール輸送層 7 中の層断裂又は薄膜化領域の増加に伴い、層断裂又は薄膜化領域とその近傍において陽極層 3 から有機発光層 8 に十分なキャリア移動がなされず有機発光層 8 において適切な光量の発光が得られない電気的劣化要因に基づく光出射効率低下を抑制することができる。

[0050]

以下、実施の形態に係る有機 E L パネル 1 0 0 における、光出射効率向上の効果について、実験結果に基づいて説明する。

4 . 効果確認実験

4 . 1 供試サンプル

実施の形態に係る有機 E L パネル 1 0 0 の陽極層 3 表面粗さとホール輸送層 7 の層断裂又は薄膜化領域との関係、及び陽極層 3 表面粗さと光出射効率との関係を調査するための実験を行った。実験は、実施の形態に係る有機 E L パネル 1 0 0 と、有機 E L パネル 1 0 0 と同様の構成において陽極層 3 の厚み及びスパッタリング条件が異なる比較例とを用いて行った。

[0051]

図6は、有機ELパネル100の性能評価試験における各サンプルの仕様及び製造条件を示す図である。図6に示すように、有機ELパネル100には、スパッタリング電力24~29(kW)、スパッタリング圧力0.3(Pa)とし(以後「標準スパッタリング 条件」とする)、スパッタリング時間17(sec)とし陽極層厚みを100mmに形成したサンプルS01及び、スパッタリング電力30~36.3(kW)、スパッタリング圧力0.18(Pa)とし(以後「高電力・低圧スパッタリング条件」とする)、スパッタリング時間27(sec)とし陽極層厚みを200mmに形成したサンプルS02を用いた。比較例には、標準スパッタリング条件にて、スパッタリング時間を、34(sec)から68(sec)まで異ならせて、陽極層厚みを200mm、300mm、350mm、400mmに形成した、サンプルS03、S04、S05、S06を用いた。サンプルS03は、図17において光出射効率の実測値と光学シミュレーション結果とが一致した陽極層膜厚200mmでの実験結果を取得したサンプルと、陽極層の膜厚及び成膜条件が同じである。

[0052]

なお、各サンプルには、絶縁層2の表面に、タングステン(W)からなる厚み40nmからなる接続層(図7を参照)を備え、接続層上に陽極層3を積層した構成を用いた。接続層は、絶縁層2の表面にタングステンをスパッタリング法により成膜し、さらにその上に成膜した陽極層3を形成するための金属材料層3Xと共にフォロリソグラフィー法によりパターンニングしドライエッチングにて形成した。

[0053]

4.2 各層の断面状態

先ず、図 6 に示す有機 E L パネル 1 0 0 及び比較例を用いて断面観察を行った。図 7 は

、有機 E L パネル 1 0 0 及び比較例の断面観察に用いた試片の形状寸法を示す模式図である。試片は横方向に 3 0 0 n m、厚み 1 0 0 n m程度のスライス状であり、試片は透過型電子顕微鏡(T E M:Transmission Electron Microscope)を用いて観察した。有機 E L パネル 1 0 0 及び比較例の断面を観察した。

[0054]

図8(a)は、有機ELパネル100における絶縁層、陽極層、ホール注入層、ホール輸送層、有機発光層に代えて実験で使用したTEM用保護層の断面を示す写真であり(b)はA部を拡大した写真である。図9(a)は、比較例における絶縁層、陽極層、ホール注入層、ホール輸送層、有機発光層に代えて実験で使用したTEM用保護層8Xの断面を示す写真であり、(b)はC部を拡大した写真、(c)はD部を拡大した写真、である。有機ELパネル100に係る写真はサンプルS02、及び比較例に係る写真はサンプルS05の断面写真を例として示した。なお、有機発光層に代えて本実験で使用したTEM用保護層8Xは有機ELパネル100の実際のデバイスでは有機発光層となる。

[0055]

図 9 (a)、(b) 及び(c) に示すように、比較例では、陽極層 3 とホール注入層 5 との境界(陽極層 3 の上面側境界)には波状の凹凸(以後、「凹凸 1 」とする)が観察された。また、ホール注入層 5 とホール輸送層 7 との境界にも、凹凸 1 と同位相で、かつ同振幅の波状の凹凸(以後、「凹凸 2 」とする)が観察された。凹凸 1 に沿ってホール注入層 5 が形成されるためである。凹凸 1 及び 2 ともに、試片の厚み方向には 1 ~ 2 周期の凹凸が透過して観察された。

[0056]

図9(b)、(c)に示すように、矢印の位置では、ホール注入層5の凹凸2のうちー部の凸部がTEM用保護層8Xに達していることが観察された。図9(a)中のB部及びE部においても、同様に、凹凸2の一部の凸部がTEM用保護層8Xに達していることが観察された。これは、ホール注入層5の一部の凸部がTEM用保護層8Xまで届き、TEM用保護層8Xと接合していることを示し、その部分ではホール輸送層7が層内部で断裂した層断裂領域又は層が薄膜化した薄膜化領域が生じていることが考えられる。

[0 0 5 7]

これに対し、有機 E L パネル 1 0 0 では、図 8 (a)及び(b)に示すように、陽極層 3 とホール注入層 5 との境界(上面境界)には、比較例の凹凸 1 よりも小さい凹凸 3 が観察され、ホール注入層 5 とホール輸送層 7 との境界にも、凹凸 3 と同位相かつ同振幅であり比較例における凹凸 2 よりも小さい凹凸 4 が観察された。また、ホール注入層 5 の凹凸 4 において凸部が T E M 用保護層 8 X まで達している箇所は観察されず、ホール輸送層 7 は試片の幅 3 0 0 n m に渡って途切れることなく連続して存在することが確認された。すなわち、比較例のようにホール輸送層 7 が層内部で断裂した層断裂又は薄膜化領域が生じていることは観察されなかった。

[0058]

図10(a)~(c)は、有機ELパネル100における陽極層、ホール注入層、ホール輸送層、有機発光層の2値化した断面画像である。図11(a)~(c)は、比較例における陽極層、ホール注入層、ホール輸送層、有機発光層の2値化した断面画像である。各図の横幅は短冊状の試片の幅300nmに相当する。図11(a)~(c)に示すように、比較例では、各試片において、ホール輸送層7が層内部で断裂した層断裂又は薄膜化領域が生じていることが確認できた。これに対し、有機ELパネル100では、図11(a)~(c)に示すように、ホール輸送層7は試片の幅300nmに渡って途切れることなく連続して存在することが確認された。

[0059]

以上、ホール輸送層 7 における層断裂又は薄膜化領域の発生について、有機 E L パネル 1 0 0 に係る断面写真はサンプルS 0 2 、比較例に係る断面写真はサンプルS 0 5 を例示して説明した。しかしながら、ホール輸送層 7 における層断裂又は薄膜化領域は、他の有機 E L パネル 1 0 0 に係るサンプルS 0 1 ではサンプルS 0 2 と同様に確認されず、他の

10

20

30

40

20

30

40

50

比較例に係るサンプルS03、S04、S06では、サンプルS05と同様に複数個所で観察された。

4 . 3 ホール輸送層厚み分布

各試片の2値画像から、ホール注入層5の厚み分布を測定した。具体的には、図10(a)~(c)、図11(a)~(c)の各試片の2値画像を幅2.8nm毎に約100分割し、幅2.8nm毎にホール輸送層7の平均厚みを算出し厚み分布を測定した。

[0060]

図12は、有機 E L パネル100及び比較例におけるホール輸送層の厚み分布の測定結果を示す図である。図12に示すように、比較例では、ホール輸送層7の厚みは4nm以上5nm未満をピークとし0nm以上11nm未満の範囲に95%以上の構成比率で分布する。これに対し、有機 E L パネル100では、8nm以上9nm未満をピークとし6nm以上15nm未満の範囲に95%以上の構成比率で分布する。

[0061]

両分布を比較すると、ピーク及び分布の裾野の厚みは、有機 E L パネル 1 0 0 が比較例に対し約 4 n m プラス方向にシフトしている。また、ピーク付近の構成比率は比較例が有機 E L パネルよりも約 1 0 % 小さい。また、比較例では 0 n m 以上 1 n m 未満の構成比率は約 9 % であり、有機 E L パネル 1 0 0 における 4 n m 以上 5 n m 未満の構成比率よりも約 8 % 大きな値を示している。

[0062]

これより、比較例では、有機 E L パネル 1 0 0 に対して低厚み方向にシフトしていることに加え、分布の尖度が小さく、厚み 0 n m 以上 1 n m 未満の構成比率が有機 E L パネル 1 0 0 に対して増加していることがわかる。すなわち、比較例では厚みのばらつきが大きく、その結果 0 n m 以上 1 n m 未満の構成比率が有機 E L パネル 1 0 0 に対して増加して いることがわかる。厚み 0 n m 以上 1 n m 未満の成比率は、ホール輸送層 7 が層内部で断裂した層断裂又は薄膜化領域の発生頻度を表すと考えられ、比較例において厚み 0 n m 以上 1 n m 未満の構成比率が大きいことは、層断裂又は薄膜化領域の発生頻度が有機 E L パネル 1 0 0 よりも大きいことを定量的に示すものといえる。

[0063]

なお、ホール輸送層7厚み分布は、概ね7nm~13nmであって、突起が殆ど存在しないような形状であり、他の有機ELパネル100に係るサンプルS01でもサンプルS 02を上回る平坦度であった。

これより、有機 E L パネル 1 0 0 では、ホール輸送層 7 における層断裂又は薄膜化領域の発生がなく、ホール輸送層 7 は陽極層 3 と重なる範囲のうち面積比 9 5 %以上において厚みが 6 n m 以上 1 5 n m 未満であることがわかる。

[0064]

4.4 陽極層表面粗さ

陽極層3のホール注入層5側の表面粗さを測定した。表面粗さの測定は、絶縁層2の上(基板1の上)に、アルミニウムまたはアルミニウム合金等の金属材料を用い、スパッタリング法により図6のサンプルS01~S06に示すスパッタリング条件で金属材料層3 Xを薄膜成形した後金属材料層3Xの焼成工程を行い、その後に、AFM(Atomic Force Microscope)を用いて各サンプルの表面粗さを測定した。

[0065]

図13は、有機ELパネル100及び比較例における陽極層のホール注入層側表面の表面粗さの測定結果を示す図であり、(a)は算術平均粗さRa、(b)は最大高さRzを示す。図13(a)(b)に示すように、陽極層3厚みの増加に伴い算術平均粗さRa、最大高さRz共に増加することが確認された。また、高電力・低圧スパッタリング条件で成膜したサンプルS02が、標準スパッタリング条件で成膜したサンプルS03よりも、算術平均粗さRa、最大高さRz共に小さい結果を示した。

[0066]

これより、有機ELパネル100に係るサンプルS01及びS02では、陽極層3は、

ホール輸送層 7 側の表面の表面粗さが、算術平均粗さ R a が 0 . 8 3 n m 以下、又は最大高さ R z が 1 3 . 8 n m 以下の少なくとも何れかを満たすことがわかる。

4.5 陽極層表面粗さと光出射効率との関係

実施の形態に係る有機 E L パネル 1 0 0 における光出射効率向上を確認するため、以下の光出射効率測定実験を行った。実験では、実施の形態に係る有機 E L パネル 1 0 0 において、陽極層 3 成膜時のスパッタリング条件を、図 6 のサンプル S 0 1 ~ S 0 6 の条件として有機 E L パネルを作成し、有機 E L パネル 1 0 0 及び比較例の光出射効率を求めた。具体的には、有機 E L パネルの陽極層 3 と陰極層 1 0 との間に陽極層 3 を正の電位とする電圧を印加して両極間に 1 0 (m A / c m²) の電流を流し青色光(波長 3 8 0 n m から4 9 5 n m) を発光させ、封止層 1 1 から出射される光の光度(カンデラ)を測定し、これを電流で除して光出射効率を算出した。

[0067]

図14は、有機ELパネル100及び比較例におけるホール注入層のホール注入層側表面粗さと光出射効率との関係を示す図であり、(a)は算術平均粗さRaとの関係、(b)は最大高さRzとの関係を示す。図14(a)、(b)における光出射効率(縦軸)は、図17において光出射効率の実測値と光学シミュレーション結果とが一致したサンプルS03における光出射効率を基準に、各サンプルにおける光出射効率を無次元化した比率である。

[0068]

[0069]

図14(a)、(b)に示すように、有機ELパネル100及び比較例では、陽極層3表面粗さの減少に伴って光出射効率は向上する結果となった。 図14(a)、(b)では、陽極層3の表面粗さがサンプルS02(Ra0.83nm、Rz13.8nm)以下の範囲において、光出射効率の実測値と光学シミュレーション結果とが一致した図17陽極層200nmでの実験結果を取得したサンプルと、同一の膜厚及び成膜条件で作成したサンプルS03(Ra0.9nm、Rz20nm)の光出射効率を上回る結果となった。

上述のとおり、光学シミュレーションと実験結果とを比較したとき、図17では陽極層厚みが200mmにおいて光出射効率の実験結果と光学シミュレーション結果が一致し、陽極層厚みが200mmを超えると実験結果が光学シミュレーション結果を下回り、陽極層厚の増加に伴いその差が増加する結果であった。

図14(a)、(b)及び図17に示す結果により、陽極層3の表面粗さが、中心線表面粗さ0.9 n m以下、又は最大高さR z 2 0 n m以下の範囲において、光学シミュレーション結果を下回らない光出射効率が得られるものと考えられる。

[0070]

したがって、有機 E L パネル 1 0 0 では、陽極層 3 の表面粗さが、中心線表面粗さ 0 .8 3 n m 以下、又は最大高さ R z 1 3 .8 n m 以下の範囲を採ることにより、光学シミュレーション結果を下回らない光出射効率が得られる。層断裂又は薄膜化領域の発生に伴う電気的な劣化要因が解消されたことにより、光学的要素を解析する光学シミュレーション結果を下回らない光出射効率が得られたものと考えられる。すなわち、有機 E L パネル 1 0 0 では、陽極層 3 の表面粗さが、中心線表面粗さ 0 .8 3 n m 以下、又は最大高さ R z 1 3 .8 n m 以下の範囲を採ることにより、光学的要因以外の電気的な光出射効率低下要因の影響を削減した発光特性を実現することができる。

[0071]

さらに、図14(a)、(b)に示すように、有機ELパネル100では、陽極層3の表面粗さが、中心線表面粗さ0.83nm以下、又は最大高さRz13.8nm以下の範囲において、光学シミュレーション結果以上の光出射効率が得られている。これは、ホール注入性や電子ブロック性が良化し電気的効率が高まり、光学シミュレーション結果以上の発光効率が得られるたものと考えられる。

[0072]

4.6 陽極層表面粗さと波長ごとの反射率との関係

20

10

30

40

20

30

40

50

図15は、有機ELパネル100及び比較例における光の波長と反射率との関係を示す実験結果を示す図である。図15に示すように、有機ELパネル100及び比較例では、波長350nmから750nmの範囲全体において、陽極層3表面粗さの減少に伴って反射率向上に伴い光出射効率が向上する結果となった。また、有機ELパネル100に係るサンプルS01及びS02では、青色光(波長380nmから495nm)を含む波長域350nmから550nmn範囲において、陽極層表面粗さの減少に伴って反射率向上に伴い光出射効率は向上効果が増加する結果となった。

[0073]

これより、有機 E L パネル 1 0 0 では、相対的に青色光(波長 3 8 0 n m から 4 9 5 n m) 波長域において、光出射効率向上効果が大きいことがわかる。

5.光出射効率が向上する理由

有機 E L パネル 1 0 0 では、ホール輸送層 7 側の表面の表面粗さが、算術平均粗さ R a 0 . 8 3 n m 以下、又は最大高さ R z 1 3 . 8 n m 以下の少なくとも何れかを満たす陽極層 3 上に、樹脂を含み湿式成膜法により形成されたホール輸送層 7 が形成された構成を有している。

[0074]

上述のとおり、ホール輸送層7はホール輸送層材料を含むインクを滴下して乾燥する湿式成膜法により成膜されるので、インクの粘性を下地の影響を受けにくい範囲に制御することにより、塗布後のインク表面をインクの表面張力により平滑にすることができる。

そのため、ホール輸送層 7 は、有機発光層側の表面が、表面粗さが算術平均粗さ R a 0 . 6 n m以下又は最大高さ R z 7 n m以下の少なくとも何れかを満たすフラットな構成とすることができる。そして、インクの塗布量を制御することにより、ホール輸送層 7 は陽極層 3 と重なる範囲の面積比 9 5 %以上の範囲において厚みを 6 n m以上 1 5 n m未満とすることができる。なお、上記面積比 9 5 %以上の範囲において厚みを 1 5 n m未満とすることができる。なお、上記面積比 9 5 %以上の範囲において厚みを 1 5 n m 未満とすることができる。

[0075]

これにより、ホール輸送層 7 は面内で途切れることなく連続して存在し、ホール輸送層 7 が層内部で断裂した層断裂又は薄膜化領域の発生を抑制できる。そのため、層断裂又は薄膜化領域とその近傍において陽極層 3 から有機発光層 8 に十分なキャリア移動がなされなず有機発光層 8 において適切な光量の発光が得られない電気的劣化要因に基づく光出射効率低下を抑制できる。すなわち、光学的要因以外の電気的な光出射効率低下要因の影響を削減し、光学シミュレーション結果を下回らない光出射効率を示す発光特性を得ることができる。

[0076]

以上が、有機 E L パネル 1 0 0 において、光出射効率が向上する理由であると考えられる。

6.まとめ

以上、説明したとおり、本実施の形態に係る有機 E L パネル 1 0 0 は、基板 1 と、アルミニウムを含む陽極層 3 と、樹脂を含み湿式成膜法により形成されたホール輸送層 7 と、陽極層から注入されたキャリアを受け取る有機発光層 8 と、陰極層 1 0 とを、当該順に積層された状態で備えた構成において、陽極層 3 は、ホール輸送層 7 側の表面の表面粗さが、算術平均粗さ R a が 0 . 8 3 n m 以下、又は最大高さ R z が 1 3 . 8 n m 以下の少なくとも何れかであり、ホール輸送層 7 は、陽極層 3 と重なる範囲のうち面積比 9 5 %以上において厚みが 6 n m 以上 1 5 n m 未満である構成を採る。

[0077]

これにより、ホール輸送層 7 が層内部で断裂した層断裂又は薄膜化領域の発生を抑制でき、層断裂又は薄膜化領域とその近傍において適切な光量の発光が得られない電気的劣化要因に基づく光出射効率低下を抑制することができる。

また、ホール輸送層7をホール輸送層材料を含むインクを滴下して乾燥する湿式成膜法

20

30

40

50

により成膜する構成を採ることにより、塗布後のインク表面を表面張力により平滑にすることができ、ホール輸送層 7 は、有機発光層側の表面の表面粗さが、算術平均粗さ R a が 0 . 6 n m以下又は最大高さ R z が 7 n m以下の少なくとも何れかを満たすよう形成することが容易となる。さらに、インクの塗布量を適切に制御することにより、ホール輸送層 7 の厚みを、陽極層 3 と重なる範囲の面積比 9 5 %以上の範囲において 6 n m以上 1 5 n m未満とすることが容易となる。

[0078]

また、陽極層3は厚みは50nm以上200nm未満に構成してもよい。これにより、陽極層3が、ホール輸送層7側の表面の表面粗さが、算術平均粗さRaが0.83nm以下又は最大高さRzが13.8nm以下の少なくとも何れかを満たすように、陽極層3を形成することが容易となる。

变形例

実施の形態では、本発明の一態様に係る有機 E L パネル 1 0 0 を説明したが、本発明は、その本質的な特徴的構成要素を除き、以上の実施の形態に何ら限定を受けるものではない。例えば、各実施の形態に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態や、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で各実施の形態における構成要素及び機能を任意に組み合わせることで実現される形態も本発明に含まれる。以下では、そのような形態の一例として、有機 E L パネル 1 0 0 の変形例を説明する。

[0079]

上記実施の形態では、トップエミッション型の有機 E L パネルを示したが、本開示はこれに限定されず、ボトムエミッション型とすることもできる。この場合、陽極層を透明材料で構成する点に留意する。

上記実施の形態では、金属酸化物膜 5 X を形成した後に金属材料層 3 X の焼成工程を実施したが、これは必須ではなく、少なくとも透明導電膜 4 X の成膜後に前記焼成工程を実施すればよい。

[0800]

上記実施の形態では、透明電極 4、ホール注入層 5、電子注入層等を設ける構成を例示したが、これらの層は適宜省略することもできる。

上記実施の形態では、絶縁層2上に直接陽極層3を積層して設ける構成を例示したが、 絶縁層2の表面に、タングステン(W)等遷移金属からなる接続層(図7参照)を備え、 接続層上に陽極層3を積層した構成としてもよい。

[0081]

また、上記実施の形態では、有機発光層の形成方法としては、印刷法、スピンコート法、スリットコート、インクジェット法などの湿式成膜プロセスを用いる構成であったが、本発明はこれに限られない。例えば、真空蒸着法、電子ビーム蒸着法、スパッタリング法、反応性スパッタリング法、イオンプレーティング法、気相成長法等の乾式成膜プロセスを用いることもできる。

[0082]

また、上記実施の形態では、有機 E L パネル 1 0 0 がアクティブマトリクス型の構成であったが、本発明はこれに限られず、例えば、パッシブマトリクス型の構成であってもよい。具体的には、バンクの延伸方向と平行な線状の電極と、バンクの延伸方向と直交する線状の電極とを有機発光層を挟むようにそれぞれ複数並設すればよい。このとき、バンクの延伸方向と直交する線状の電極を下部側とすれば、各間隙では、複数の下部側の電極が、互いに間隔をあけてバンクの延伸方向に並び、本発明の一態様となる。その場合には、各構成について、適宜の変更が可能である。なお、上記実施の形態 1 では、基板 1 が T F T 層を有する構成であったが、上記パッシブマトリクス型の例などから分かるように、基板 1 は T F T 層を有する構成に限られない。

【産業上の利用可能性】

[0083]

本発明に係る有機ELパネルを用いた表示装置は、テレビジョンセット、パーソナルコ

ンピュータ、携帯電話などの装置、又はその他表示パネルを有する様々な電子機器に広く 利用することができる。

【符号の説明】

[0 0 8 4]

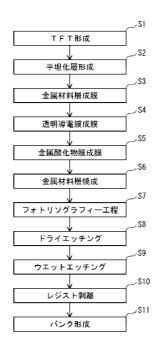
- 1 基板
- 2 絶縁層
- 3 X 金属材料層
- 3 陽極層
- 4 X 透明導電膜
- 4 透明電極
- 5 X 遷移金属酸化物膜
- 5 ホール注入層
- 6 バンク
- 7 ホール輸送層
- 8 有機発光層
- 9 電子注入層
- 10 陰極層
- 1 1 封止層
- 20 a、20 b、20 c 有機 E L 素子
- 100 有機 E L パネル

20

10

【図1】

【図2】



【図3】

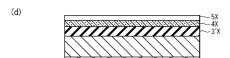
【図4】

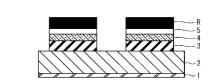
(a) -2 -1 (b)

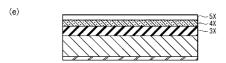


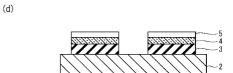
(c)









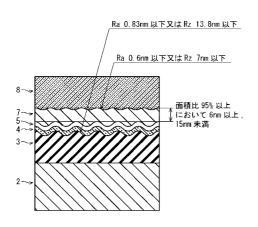




【図5】

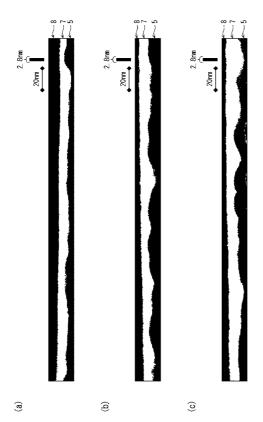
【図6】

(c)

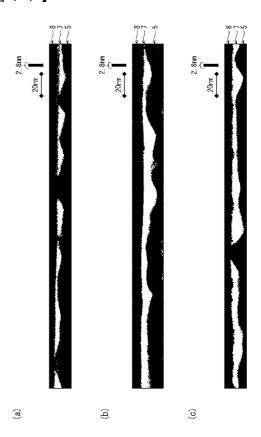


		接続層		陽極	極	
サンプル	5	(m 7, []	Υ'	スパッタリング条件	#	[100]
		世の	電力 [k//]	压力 [Pa]	時間 [sec]	世の世
有機ELパネル	108		24~29	0.3	17	100
001	202		30~36.3	0.18	27	200
	203	9	24~29	0.3	34	200
1. 44. (b)	804	5	24~29	0.3	51	300
TC#XPJ	305		24~29	0.3	59.5	350
	908		24~29	0.3	89	400

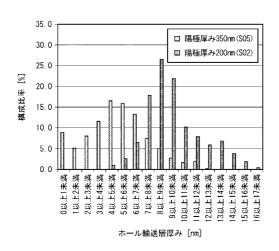
【図10】



【図11】

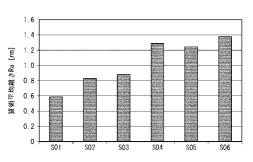


【図12】

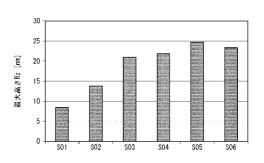


【図13】



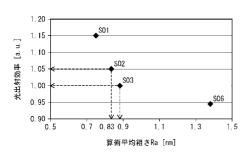


(b)

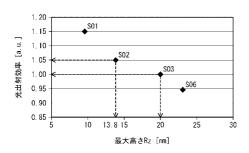


【図14】

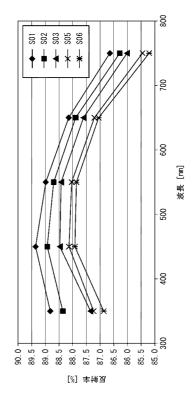
(a)



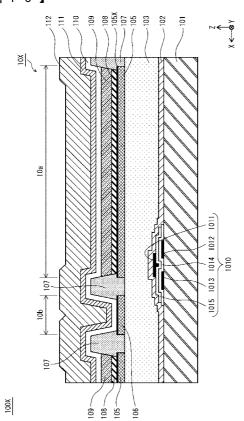
(b)



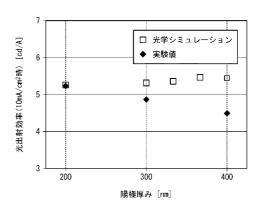
【図15】



【図16】

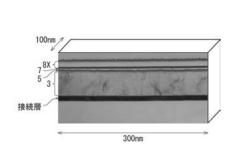


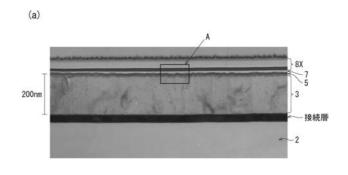
【図17】



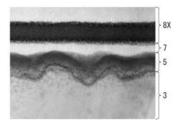
【図7】

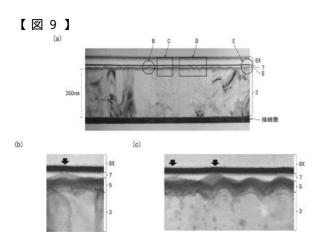






(b)







专利名称(译)	有机EL面板				
公开(公告)号	<u>JP2016115714A</u>	公开(公告)日	2016-06-23		
申请号	JP2014251029	申请日	2014-12-11		
[标]申请(专利权)人(译)	日本有机雷特显示器股份有限公司				
申请(专利权)人(译)	株式会社JOLED				
[标]发明人	阿部裕樹				
发明人	阿部 裕樹				
IPC分类号	H01L51/50 H05B33/26				
FI分类号	H05B33/22.D H05B33/26.Z H05B33/14.A H05B33/22.C				
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC05 3K107/CC25 3K107/DD23 3K107/DD44X 3K107/DD72 3K107/DD73 3K107/DD78 3K107/DD79 3K107/DD84 3K107/DD87 3K107/FF08 3K107/FF15 3K107/GG05 3K107/GG06				
外部链接	Espacenet				

摘要(译)

要解决的问题:提高有机EL面板的发光效率。 解决方案:在有机EL面板中,依次提供基板,包含铝的阳极层3,通过湿膜形成方法形成的包含树脂的空穴传输层7,有机发光层8和阴极层。 以层叠状态设置阳极层3,空穴传输层7侧的表面的表面粗糙度,算术平均粗糙度Ra为0.83nm以下,或者最大高度Rz为13.8nm以下的至少之一。 空穴传输层7在与阳极层3重叠的范围内的面积比为95%以上且具有6nm以上且小于15nm的厚度。 [选择图]图5

